

上海聚跃检测技术有限公司

地址: 上海市徐汇区钦江路 333 号 37 号楼一楼

序号	产品/产品类别	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	测量容量	备注
		序号	名称				
1	电工电子产品/ 电子半导体产品	1	恒定湿热试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》 GB/T 2423. 3-2016	只测: 温度: +30℃ /+40℃, 相对湿度: 85%RH/93%RH	内箱尺寸 (长×宽 ×高): 1000mm×1000mm×1000mm	
				《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cy: 恒定湿热主要用于元件的加速试验》 GB/T 2423. 50-2012	只测: 温度: +85℃, 相对湿度: 85%RH	内箱尺寸 (长×宽 ×高): 1000mm×1000mm×1000mm	
		2	温度循环试验	《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 N: 温变变化》 GB/T 2423. 22-2012	只测: 试验 Nb; 温度: -65℃~+150℃, 温度变化率: ≤5℃/min	内箱尺寸 (长×宽 ×高): 500mm×400mm×400mm	
		3	温度存储试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 A: 低温》 GB/T 2423. 1-2008	只测: 方法 Ab; 温度: -65℃~+5℃	内箱尺寸 (长×宽 ×高): 1000mm×1000mm×1000mm	
				《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 B: 高温》 GB/T 2423. 2-2008	只测: 方法 Bb; 温度: +30℃~+250℃	内箱尺寸 (长×宽 ×高): 800mm×950mm×1440mm	
		4	外观目检	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 2009. 2	只测: 放大倍数 3 倍 ~50 倍		
		5	开封实验	军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB-4027B-2021 中 1103 中 2. 6. 2			
		6	去层试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3. 3. 3		尺寸不能超过 8 寸	
7	电性验证试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3. 2. 3. 3. 2. 4		量程: ±9v 500mA 分辨率 2uA			

		8	红外扫描试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.4 (d)		波长:1300nm, 检测电压范围:0~20v, 检测电流能力:0-100mA	
		9	探针试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.2.12			
		10	声学扫描显微镜检查	军用电子元器件破坏性分析物理分析方法 GJB-4027B-2021 中方法 1103 中 2.5	只测: 25MHZ 探头频率		
2	非密封表面贴装器件/电子半导体产品	1	预处理试验	《非密封表面贴装器件在可靠性测试之前的预处理方法》 JSED22-A113I-2020 条款 5	只测: 温度储存: 温度: 125℃ 温湿度储存: 温度: 30℃/60℃/85℃, 相对湿度: 60%RH/85%RH 回流焊模拟: 只测对回流焊; 温度最高: 300℃	温度储存尺寸 (长×宽×高): 950mm X800mmX1440mm; 温湿度储存尺寸 (长×宽×高): 1000mm×1000mm ×1000mm 回流焊尺寸 (长×宽×高): 500mm×400mm×50mm	
				《非密封表面贴装器件在可靠性测试之前的预处理方法》 J-STD-020F-2022 条款 5	只测: 温度储存: 温度: 125℃ 温湿度储存: 温度: 30℃/60℃/85℃, 相对湿度: 60%RH/85%RH 回流焊模拟: 只测对回流焊; 温度最高: 300℃	温度储存尺寸 (长×宽×高): 950mmX800mmX1440mm; 温湿度储存尺寸 (长×宽×高): 1000mm×1000mm ×1000mm 回流焊尺寸 (长×宽×高): 500mm×400mm×50mm	
				《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J	只测: 温度储存: 温度: 125℃ 温湿度储存: 温度: 30℃/60℃/85℃, 相对湿度: 60%RH/85%RH 回流焊模拟: 只测对回流焊; 温度最高: 300℃	温度储存尺寸 (长×宽×高): 950mmX800mmX1440mm; 温湿度储存尺寸 (长×宽×高): 1000mm×1000mm ×1000mm 回流焊尺寸 (长×宽×高): 500mm×400mm×50mm	

			《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-RCV-E	只测: 温度储存: 温度: 125℃ 温湿度储存: 温度: 30℃/60℃/85℃, 相对湿度: 60%RH/85%RH 回流焊模拟: 只测对回流焊; 温度最高: 300℃	温度储存尺寸 (长×宽×高): 950mmX800mmX1440mm; 温湿度储存尺寸 (长×宽×高): 1000mm×1000mm×1000mm 回流焊尺寸 (长×宽×高): 500mm×400mm×50mm	
		2	《稳态温湿度偏压寿命试验》 JESD22-A101D. 01-2021 条款 4	只测: 温度: 85℃, 相对湿度: 85%RH	内箱尺寸 (长×宽×高): 1000mm×1000mm×1000mm	
			《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J	只测: 温度: 85℃, 相对湿度: 85%RH	内箱尺寸 (长×宽×高): 1000mm×1000mm×1000mm	
		3	《温度、偏压和工作寿命》 JESD22-A108G-2022 条款 4	只测: 温度: 25℃~175℃	温度储存尺寸 (长×宽×高): 950mmX800mmX1440mm	
			《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J	只测: 温度: 25℃~175℃	温度储存尺寸 (长×宽×高): 950mmX800mmX1440mm	
		4	《高温存储寿命测试》 JESD22-A103E. 01-2021 条款 4	只测: 温度: 125℃~200℃	温度储存尺寸 (长×宽×高): 950mmX800mmX1440mm	
			《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J	只测: 温度: 125℃~200℃	温度储存尺寸 (长×宽×高): 950mmX800mmX1440mm	
		5	《加速抗湿-无偏压高加速应力试验》 JESD22-A118B. 01-2021 条款 4	只测: 温度: 130℃/110℃, 相对湿度: 85%RH, 压力: 122kPa/230kPa	内箱尺寸 (直径 X 深): 340mmX475mm	
			《高加速温湿度试验》 JESD22-A110E. 01-2021 条款 4	只测: 温度: 130℃/110℃, 相对湿度: 85%RH, 压力: 122kPa/230kPa	内箱尺寸 (直径 X 深): 340mmX475mm	
			《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J	只测: 温度: 130℃/110℃, 相对湿度: 85%RH, 压力: 122kPa/230kPa	内箱尺寸 (直径 X 深): 340mmX475mm	
			《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-RCV-E	只测: 温度: 130℃/110℃, 相对湿度: 85%RH, 压力: 122kPa/230kPa	内箱尺寸 (直径 X 深): 340mmX475mm	

		6	高压蒸煮试验	《无偏置电压高压力蒸煮》 JESD22-A102E-2015 条款 4	只测：温度：121℃， 相对湿度：100%RH	内箱尺寸（直径 X 深）： 340mmX475mm	
				《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J	只测：温度：121℃， 相对湿度：100%RH	内箱尺寸（直径 X 深）： 340mmX475mm	
				《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-RCV-E	只测：温度：121℃， 相对湿度：100%RH	内箱尺寸（直径 X 深）： 340mmX475mm	
		7	温度循环试验	《温度循环测试》 JESD22-A104F.01-2023 条款 4, 条件 B,C	只测：温度：-65℃ ~150℃	内箱尺寸（长 X 宽 X 高）： 400mm×500mm×400mm。不测：连接件。	
				《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J	只测：温度：-65℃ ~150℃	内箱尺寸（长 X 宽 X 高）： 400mm×500mm×400mm。不测：连接件。	不测等级 0
				《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-RCV-E	只测：温度：-65℃ ~150℃	内箱尺寸（长 X 宽 X 高）： 400mm×500mm×400mm。不测：连接件。	